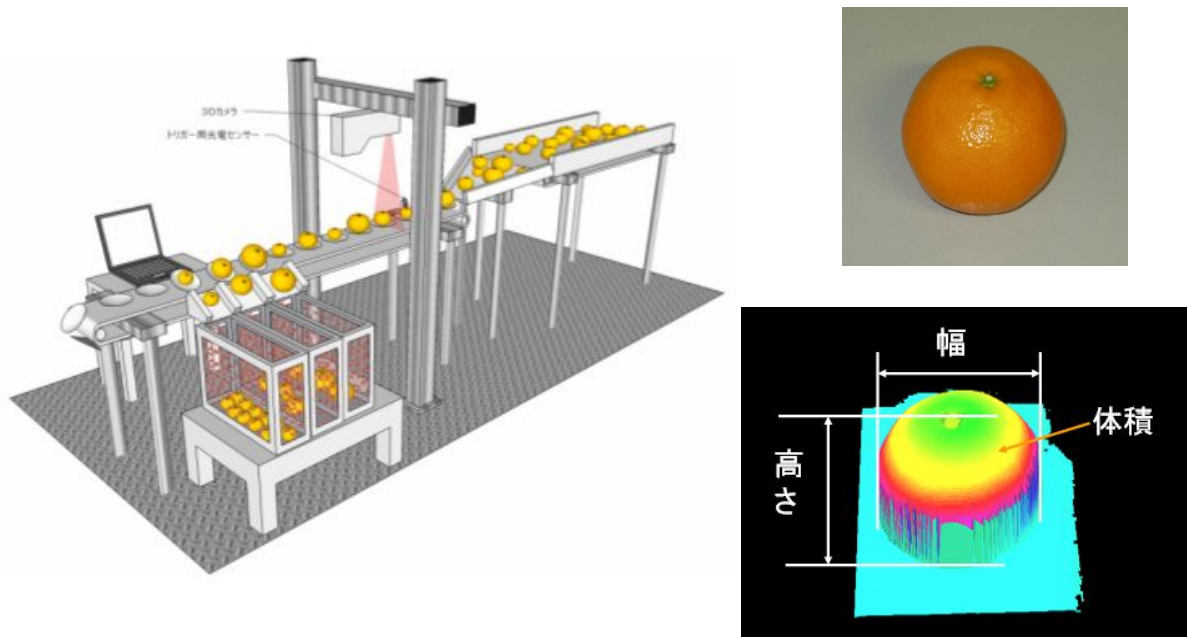


寸法と体積測定による 仕分け装置

3Dカメラで3D画像を撮像し、
幅・長さ・高さ・体積で高速仕分けが可能！
結果をPCで受信し、不良発生分布などの分析可能。

計測イメージ



検査仕様 <ドイツのSICK社/IVC3D 100の場合>

機能	幅・長さ・高さ・体積で仕分け/閾値設定/PCへ計測値送信
性能	速度: 7000個/時間
高さ分解能	0.05mm
ワーク	対象: 野菜、果物、パン...など 対応サイズ: 幅~180mm、高さ: ~150mm



テクニカルシステム株式会社

〒160-0022

東京都新宿区新宿2-12-16セントフォビル 8F TEL: 03-5312-2381

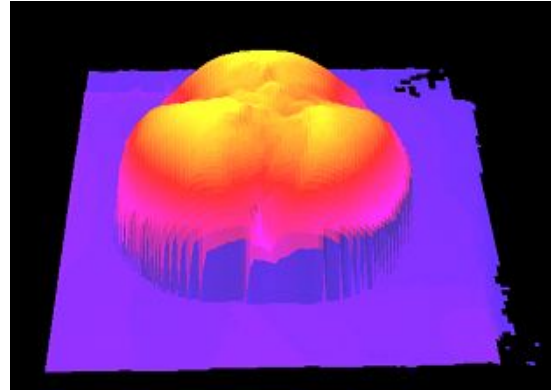
<http://www.tscn.co.jp/>

FAX: 03-5312-2382

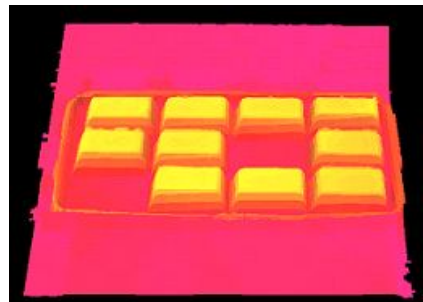
3D撮像イメージ

3Dカメラで撮像した距離画像に対して画像処理を行うことで
種々の計測・検査が可能となります。

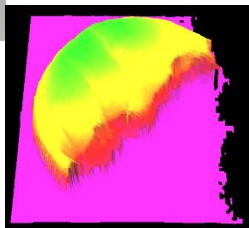
◎焼き菓子 ※表面の凹凸の計測



◎チョコレート
※同系色のトレイ上での抜きの検査



◎ちぎったアンパン



◎その他パン

※ゴマの数も計測可能

